



2024年5月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2023年12月26日

上場会社名 三益半導体工業株式会社
コード番号 8155
代表者 (役職名) 代表取締役社長
問合せ先責任者 (役職名) 管理本部 本部長
四半期報告書提出予定日 2024年1月12日
四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
四半期決算説明会開催の有無 : 無

上場取引所 東
URL <https://www.mimasu.co.jp/>
(氏名) 八高 達郎
(氏名) 中島 孝之 (TEL) 027-372-2021
配当支払開始予定日 2024年2月2日

(百万円未満切捨て)

1. 2024年5月期第2四半期の業績(2023年6月1日～2023年11月30日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2024年5月期第2四半期	44,018	2.6	6,670	△5.5	6,713	△4.4	4,658	△4.3
2023年5月期第2四半期	42,902	23.5	7,059	71.4	7,021	70.0	4,865	72.8

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2024年5月期第2四半期	145.02	—
2023年5月期第2四半期	151.45	—

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2024年5月期第2四半期	119,602	80,073	66.9
2023年5月期	124,339	76,396	61.4

(参考)自己資本 2024年5月期第2四半期 80,073百万円 2023年5月期 76,396百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2023年5月期	—	32.00	—	32.00	64.00
2024年5月期	—	32.00	—	—	—
2024年5月期(予想)	—	—	—	32.00	64.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2024年5月期の業績予想(2023年6月1日～2024年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	86,000	△5.4	10,300	△7.8	10,150	△7.7	7,030	△7.7	218.84

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2024年5月期2Q	35,497,183株	2023年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	2024年5月期2Q	3,373,230株	2023年5月期	3,373,211株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2024年5月期2Q	32,123,953株	2023年5月期2Q	32,124,472株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料3ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	3
2. 四半期財務諸表及び主な注記	4
(1) 四半期貸借対照表	4
(2) 四半期損益計算書	6
(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書	7
(4) 四半期財務諸表に関する注記事項	8
(継続企業の前提に関する注記)	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	8
(セグメント情報)	8

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第2四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な資源価格高騰や海外経済の下振れなどの影響を受けたものの設備投資や個人消費が持ち直すなど、全体として緩やかな回復基調が継続いたしました。

半導体シリコンウエハーの生産は引き続きデバイス市場における在庫調整の影響を受けましたが、当社の主要なユーザーである半導体関連各社の設備投資は底堅く推移しました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第2四半期累計期間の売上高は440億1千8百万円と前年同四半期比2.6%の増収となりましたが、営業利益は66億7千万円(前年同四半期比5.5%減)、経常利益は67億1千3百万円(同4.4%減)、四半期純利益は46億5千8百万円(同4.3%減)となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。なお、売上高及び利益には、セグメント間の内部取引に係る金額が含まれております。

半導体事業部

当事業部はデバイス市場における在庫調整の影響を受けました。

この結果、当事業部の売上高は238億2千6百万円(前年同四半期比12.8%減)、セグメント利益(営業利益)は53億3千8百万円(同5.6%減)となりました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。

この結果、その他の取扱商品において増収となり、当事業部の売上高は210億4千9百万円(前年同四半期比34.1%増)、セグメント利益(営業利益)は11億4千6百万円(同5.2%増)となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

この結果、当事業部の売上高は27億8百万円(前年同四半期比32.4%減)、セグメント利益(営業利益)は3億9千4百万円(同20.8%減)となったものの、前四半期比では増収となりました。

(2) 財政状態に関する説明

①資産、負債及び純資産の状況

当第2四半期会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少等により、前事業年度末と比較して47億3千7百万円減少し、1,196億2百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の減少等により84億1千3百万円減少し、395億2千9百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加36億3千万円等により、800億7千3百万円となりました。

②キャッシュ・フローの状況

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は172億3千2百万円となり、前事業年度末に比べ40億8百万円の減少となりました。営業活動の結果得られた資金は88億6千9百万円となりました。これは仕入債務の減少41億6千6百万円等による資金の減少があったものの、税引前四半期純利益67億2千9百万円や減価償却費41億4千3百万円等により資金が増加したことによるものです。投資活動の結果使用した資金は118億4千7百万円となりました。これは、有形固定資産の取得による支出168億1千2百万円等があったことによるものです。財務活動の結果使用した資金は10億3千5百万円となりました。これは配当金の支払10億2千8百万円等があったことによるものです。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、2023年9月29日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年5月31日)	当第2四半期会計期間 (2023年11月30日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	27,240	18,232
受取手形及び売掛金	40,063	36,764
商品及び製品	4,692	3,057
仕掛品	1,370	1,436
原材料及び貯蔵品	4,347	4,916
その他	3,349	877
貸倒引当金	△4	△3
流動資産合計	81,059	65,281
固定資産		
有形固定資産		
建物（純額）	21,502	20,755
機械及び装置（純額）	8,461	8,270
建設仮勘定	3,298	14,968
その他（純額）	4,521	5,339
有形固定資産合計	37,783	49,333
無形固定資産	809	797
投資その他の資産	4,687	4,190
固定資産合計	43,280	54,321
資産合計	124,339	119,602
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	30,919	26,752
未払法人税等	3,172	1,755
引当金	110	50
その他	13,533	10,363
流動負債合計	47,735	38,923
固定負債		
退職給付引当金	41	—
その他	166	606
固定負債合計	207	606
負債合計	47,943	39,529

(単位：百万円)

	前事業年度 (2023年5月31日)	当第2四半期会計期間 (2023年11月30日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	43,466	47,096
自己株式	△4,772	△4,772
株主資本合計	76,295	79,926
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	140	178
繰延ヘッジ損益	△39	△31
評価・換算差額等合計	100	146
純資産合計	76,396	80,073
負債純資産合計	124,339	119,602

(2) 四半期損益計算書
(第2四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)
売上高	42,902	44,018
売上原価	32,489	34,827
売上総利益	10,412	9,191
販売費及び一般管理費	3,353	2,520
営業利益	7,059	6,670
営業外収益		
受取利息	0	0
受取配当金	9	12
保険解約返戻金	—	32
その他	65	52
営業外収益合計	75	96
営業外費用		
支払利息	0	3
固定資産除売却損	113	50
その他	0	0
営業外費用合計	113	53
経常利益	7,021	6,713
特別利益		
投資有価証券売却益	—	18
特別利益合計	—	18
特別損失		
投資有価証券売却損	—	2
特別損失合計	—	2
税引前四半期純利益	7,021	6,729
法人税、住民税及び事業税	2,724	1,571
法人税等調整額	△568	499
法人税等合計	2,156	2,071
四半期純利益	4,865	4,658

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第2四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)	当第2四半期累計期間 (自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー		
税引前四半期純利益	7,021	6,729
減価償却費	4,726	4,143
受取利息及び受取配当金	△10	△12
支払利息	0	3
為替差損益 (△は益)	△3	△4
売上債権の増減額 (△は増加)	△3,885	3,299
棚卸資産の増減額 (△は増加)	△450	999
仕入債務の増減額 (△は減少)	2,195	△4,166
その他	1,638	804
小計	11,232	11,795
利息及び配当金の受取額	10	12
利息の支払額	△0	△3
法人税等の支払額	△2,702	△2,935
営業活動によるキャッシュ・フロー	8,540	8,869
投資活動によるキャッシュ・フロー		
定期預金の預入による支出	△6,000	△2,000
定期預金の払戻による収入	6,000	7,000
有形固定資産の取得による支出	△3,591	△16,812
有形固定資産の売却による収入	6	1
無形固定資産の取得による支出	△41	△126
その他	△102	90
投資活動によるキャッシュ・フロー	△3,729	△11,847
財務活動によるキャッシュ・フロー		
配当金の支払額	△834	△1,028
その他	△0	△7
財務活動によるキャッシュ・フロー	△834	△1,035
現金及び現金同等物に係る換算差額	3	4
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	3,979	△4,008
現金及び現金同等物の期首残高	19,326	21,240
現金及び現金同等物の四半期末残高	23,306	17,232

(4) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第2四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2022年11月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	27,333	15,568	—	42,902	—	42,902
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	126	4,006	4,134	△4,134	—
合計	27,335	15,694	4,006	47,036	△4,134	42,902
セグメント利益	5,652	1,089	498	7,240	△181	7,059

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3 エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行うため外部顧客への売上高は発生しておりません。

当第2四半期累計期間(自 2023年6月1日 至 2023年11月30日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	23,826	20,192	—	44,018	—	44,018
セグメント間の内部売上高 又は振替高	0	857	2,708	3,566	△3,566	—
合計	23,826	21,049	2,708	47,585	△3,566	44,018
セグメント利益	5,338	1,146	394	6,879	△209	6,670

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3 エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行うため外部顧客への売上高は発生しておりません。